



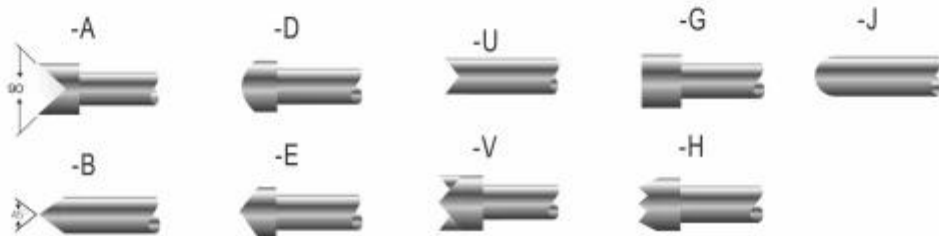
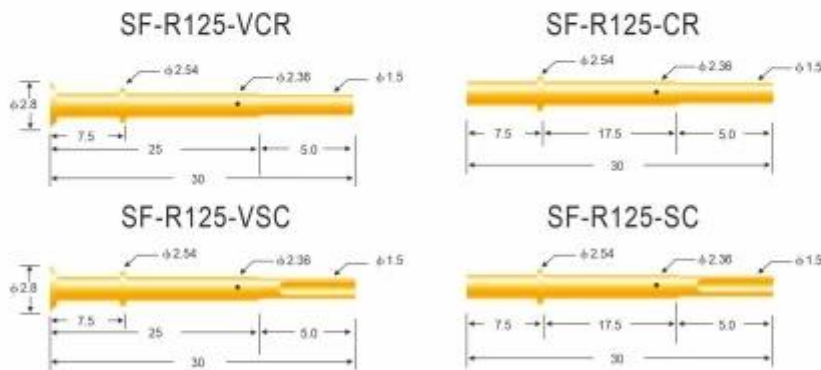
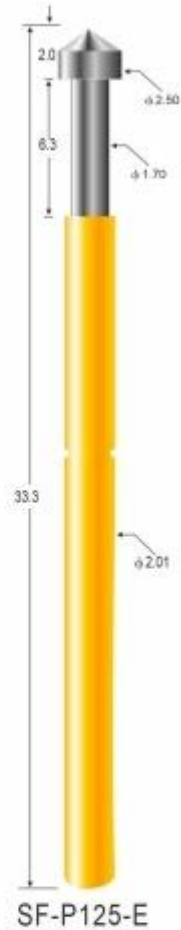
SFENG 1984 ( )



### 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center <b>最小间距</b>	3.17mm(.1248 ")
Mounting hole size <b>钻孔尺寸</b>	压克力: 2.45mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel <b>行程</b>	6.3(.2481 ")
Spring force <b>弹簧压力</b>	120g(克)
Materials and finishes <b>材料及涂饰</b>	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Brass, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration <b>额定电流</b>	3A(安培)
Contact resistance <b>接触电阻</b>	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications  
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



厚度	1.90mm±.0748"
公差	±.135mm±.0532" ±.140mm±.0551"
长度	6.30±.2481"
宽度	120
材料	Be Cu,Rh 镀层厚度 镀层厚度
电压	3A
电流	50
电阻	100
重量	±.007

### 测试

1. 测试24小时稳定性
2. 测试OEM
3. 测试接触电阻
4. 测试接触寿命

### 应用

1. PCB ICT FCT
2. Pogo pin
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
6. /
7. 30#OK POM

测试报告

### 备注



□□□□



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



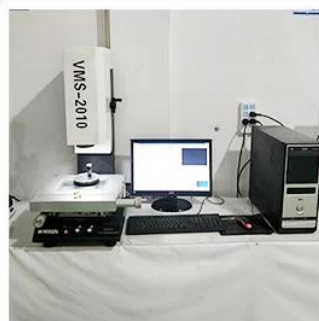
**5. Finished products**



**6. Packing**



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**



Q1. 請說明

A1: 請說明

Q2. 請說明

A2: 請說明

Q3. 請說明

A3: 請說明

Q4. 請說明

A4: 請說明

Q5. 請說明

A5: 請說明

Q6. 請說明

A6: 請說明

Q7. 請說明 OEM 與 ODM 的區別

A7: 請說明 OEM / ODM 的區別。P 代表製造商，OEM 代表原始設備製造商，ODM 代表原始設計製造商。

Q8. 請說明

A8: 請說明

請說明

請說明 DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS 的區別

請說明 Exwork、FOB、CNF、CIF 的區別



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

